
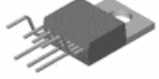
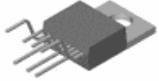














Корпуса и обозначение ИС выпускаемых компанией National Semiconductor

Название корпуса	Буквы в обозначении микросхемы	Пример обозначения	Внешний вид
SOT223	MP	LM1117EMP-3.3	
TO-220	T	LM1117T-3.3	
Изолированный TO-220	TF	LM4700TF	
<b>LAMINATE CSP</b>	SLB	LMX1601SLB	
<b>LAMINATE TCSP</b>	SLD	LMX2310USLD	
LLP	LD	LM2623LD	
<b>LQFP</b>	VT	ADC10030CIVT	
DIP	N	LF347N	
Micro SMD	BP	LM3700XCBP-290	
MINI SOIC	MM	ADC104S021CIMM	
PLCC	V	DS36950V	
<b>PQFP</b>	VF	LM12H458CIVF	
PSOP	MR	LM7372MR	
SC-70	MG или M7	LM20BIM7 LMS5214IMG-2.8	
SOT23	M3, M5 или MF	LMH6645MF LM4125IM5X-2.5 LM4051BEM3-1.2	

SOIC	M	ADC08831IM	
SOIC широкий	WM, иногда M	ADC0832CCWM	
SSOP	MQ	LM85BIMQ	
TO-252 (D-PACK)	DT	LM1117DT-1.8	
TO-263	S	LM1084IS-12	
TO-92	Z	LM19CIZ	
TQFP	VS	DS90C124IVS	
TSOT	MK	DAC081S101CIMK	
CERDIP (керамический)	---	CLC432AJ-MLS	
TO-3	K	LM138K-MIL	
TO-5	H	LM108AH	
TO-46	H	LM185H-1.2	
TSSOP	MT	DS36C200IMT	

- Корпуса на рисунке могут отличаться количеством выводов
- Масштаб не соблюден

Datasheet Directory